****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reader Enquiries:**  | **Press Contact:** |  |
| **congatec Japan K.K.** | **congatec Japan K.K.** |  |
| Eric Hsu | Crysta Lee |  |
| Phone: +81-3-64359250 | Phone: +886-2-27754645 |  |
| sales-jp@congatec.comwww.congatec.jp  | crysta.lee@congatec.comwww.congatec.jp |  |

**** *Server-on-Modules: congatec’s new COM Express Basic modules with the latest Intel® Core™ and Intel® Xeon® processors deliver server-class embedded performance*

congatec が新しい
Intel® Xeon®/Core™ プロセッサーを搭載したサーバーオンモジュールを発売

**congatec の新しい COM Express モジュールはサーバー級の組み込みパフォーマンスを届けます**

組み込みコンピューターモジュール、SBC (シングルボードコンピューター)、EDM (組み込み設計・製造) サービスで業界をリードするテクノロジー企業、congatec AG は COM Express Basic シリーズに新しいサーバー級組み込みモジュールを追加しました。新しいサーバーオンモジュールは第 6 世代の Intel® Xeon®/Intel® Core™ i3 / i5 / i7 プロセッサー (コードネーム「Skylake」) を備えています。conga-TS170 モジュールの DDR4 メモリはデータが集中するアプリケーションに最大 2 倍のシステムメモリパフォーマンスを提供しながら、エネルギー消費は 20% 少なく、将来の廃止が予想されている DDR3 RAM と比べて専有面積が約半分になります。また、プロセッサーが高速になり、システムバスが 60% 加速し、Intel® Smart Cache が増加しました (最大 8 MB)。あらゆる PCIe レーンと新しい Intel® HD Graphics P530 に対して PCIe Gen 3.0 がサポートされます。全体的に、省スペース、省エネルギーの要件のもとでシステムパフォーマンスと記録密度の強化によるメリットを期待できます。

新しいモジュールは、25-45W TDP の熱出力エンベロープ内で動作し、I/O と IoT のカスタムインターフェイスを必要とするサーバー級の組み込み設計のために開発されました。Intel Core プロセッサーを備えた新しい conga-TS170 モジュールは、テストや測定用の機器、医療画像のバックエンドシステム、高パフォーマンスな産業用ワークロードステーション、インテリジェント自動販売機などの用途に適しています。

Intel® Xeon® モジュールは ECC メモリ保護も提供し、用途がデータクリティカルなサーバーやゲートウェイに拡大されます。用途にはビッグデータを分析する産業 IoT/クラウドサーバー、通信業者級のエッジノードサーバー、複数の仮想マシンをホストするインダストリ 4.0 自動化サーバー、複数のストリーム動画をリアルタイム変換するメディアサーバーがあります。

また、新しい conga-TS170 モジュールは、IoT、M2M、インダストリ 4.0 の分散アプリケーションを管理するための強力なツールを提供します。このモジュールは、Intel® vPro 技術、congatec のボード管理コントローラー、ウォッチドッグタイマー、電力損失制御を駆使し、監視、管理、保守のリモートタスクを完全にこなします。アウトオブバンド管理にも対応します。

予算が限られ、複雑なアウトオブバンド管理や仮想化が必ずしも必要ない場合、Intel® Core™ i3 プロセッサーや Mobile Intel® HM170 チップセットをベースとするモジュールもご利用いただけます。

**機能詳細**

新しい conga-TS170 モジュールは最新の第 6 世代の 14nm Xeon® v5 プロセッサーまたは Intel® Core™ プロセッサーを備えています。25-45W の TDP、最大 8MB のスマートキャッシュ、最大 32 GB の超高速 2133 DDR4 メモリを備えており、Intel® Xeon シリーズの安全性重視の用途ではメモリは ECC メモリとして実装されます。新しいモジュールは以前の S3 モードの代わりに接続待機 (Disconnected Standby) 対応となり、エネルギー効率に優れた年中無休 (24/7) の運用を実現します。接続待機を利用すると、省エネルギーのスリープモードから完全パフォーマンスに 2 分の 1 秒で切り替えられ、結果的に使いやすさや応答性に影響を与えることなく、システムは頻繁にスリープモードに入ることができます。

第 9 世代 Intel® HD Graphics 530 内蔵で DirectX 12 対応となり、Windows 10 ベースの高速 3D グラフィックスが HDMI 1.4、DVI、DisplayPort 1.2 経由で最大 3 台の4K (3840 x 1260) ディスプレイで個別に再生されます。古いアプリケーションについては、デュアルチャンネルの LVDS 出力とオプションの VGA を利用できます。HEVC、VP8、VP9、VDENC のデコーディングとエンコーディングをハードウェアサポートすることで、HD 動画の双方向へのストリーミングがエネルギー効率良くできるようになりました。

PCI Express Gen 3.0 Graphics (PEG) 以外に、利用可能な I/O インターフェイスには、PCI Express Gen 3.0 レーン x8、USB 3.0 x4、USB 2.0 x8、LPC、I²C があります。SSD、HDD、BluRay のマスストレージを、RAID 0、1、5、10 を含む、4 つの SATA 3.0 に接続できます。Linux と Microsoft Windows の主要なあらゆるオペレーティングシステムに対応しており、Windows 10 も含まれています。冷却ソリューション、キャリアボード、スターターキットなど、包括的なアドオンセットでデザインインが簡単になります。

**プロセッサーの種類:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processor** |  | **Cores** |  | **Smart Cache [MB]** |  | **Clock [GHz]** |  | **Turbo Boost [GHz]** |  | **TDP [W]** |  | **graphics** |
| **Intel® Core™ i7-6820EQ** |  | **4** |  | **8** |  | **2.8** |  | **3.5** |  | **45** |  | **Intel® HD Graphics 530** |
| **Intel® Core™ i7-6822EQ** |  | **4** |  | **8** |  | **2.0** |  | **2.8** |  | **25** |  | **Intel® HD Graphics 530** |
| **Intel® Core™ i5-6440EQ** |  | **4** |  | **6** |  | **2.7** |  | **3.4** |  | **45** |  | **Intel® HD Graphics 530** |
| **Intel® Core™ i5-6442EQ** |  | **4** |  | **6** |  | **1.9** |  | **2.7** |  | **25** |  | **Intel® HD Graphics 530** |
| **Intel® Core™ i3-6100E** |  | **2** |  | **3** |  | **2.7** |  | **-** |  | **35** |  | **Intel® HD Graphics 530** |
| **Intel® Core™ i3-6102E** |  | **2** |  | **3** |  | **1.9** |  | **-** |  | **25** |  | **Intel® HD Graphics 530** |
| **Intel® Xeon® E3-1505M v5** |  | **4** |  | **8** |  | **2.8** |  | **3.7** |  | **45 / 35** |  | **Intel® HD Graphics P530** |
| **Intel® Xeon® E3-1505L v5** |  | **4** |  | **8** |  | **2.0** |  | **2.8** |  | **25** |  | **Intel® HD Graphics P530** |

新しい conga-TS170 モジュールに関するデータシートと追加情報は次の場所でご利用いただけます: <http://www.congatec.com/products/com-express-type6/conga-ts170.html>.

**congatec AGについて**

ドイツのデッゲンドルフに本社を置き、congatec AGは標準的なフォームファクタQseven、COM Express、XTXとETX以外にシングルボードコンピュータやEDMサービスも提供しているリーディング・サプライヤです。 congatec社の製品は、産業オートメーション、医療、エンターテインメント、交通、通信、テスト＆計測およびPOSなどの様々な用途に対応できます。コアの知識と技術的なノウハウは、ユニークなBIOS機能を拡張するだけでなく、総合的なドライバとボードサポートパッケージが含まれています。デザイン・イン段階から、顧客は広範な製品ライフサイクル管理サポートを与えられています。同社の製品は、近代的な品質基準に基づいて専門サービスプロバイダによって製造されています。現在のcongatecは台湾、日本、中国、アメリカ、オーストラリア、チェコ共和国に販売拠点を持っています。詳しい情報は当社のウェブサイト[www.congatec.jp](http://www.congatec.jp)、あるいはFacebook、TwitterやYouTubeを経由して上で利用可能です。

\* \* \*

*Intel and Intel Xeon, Core are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.*